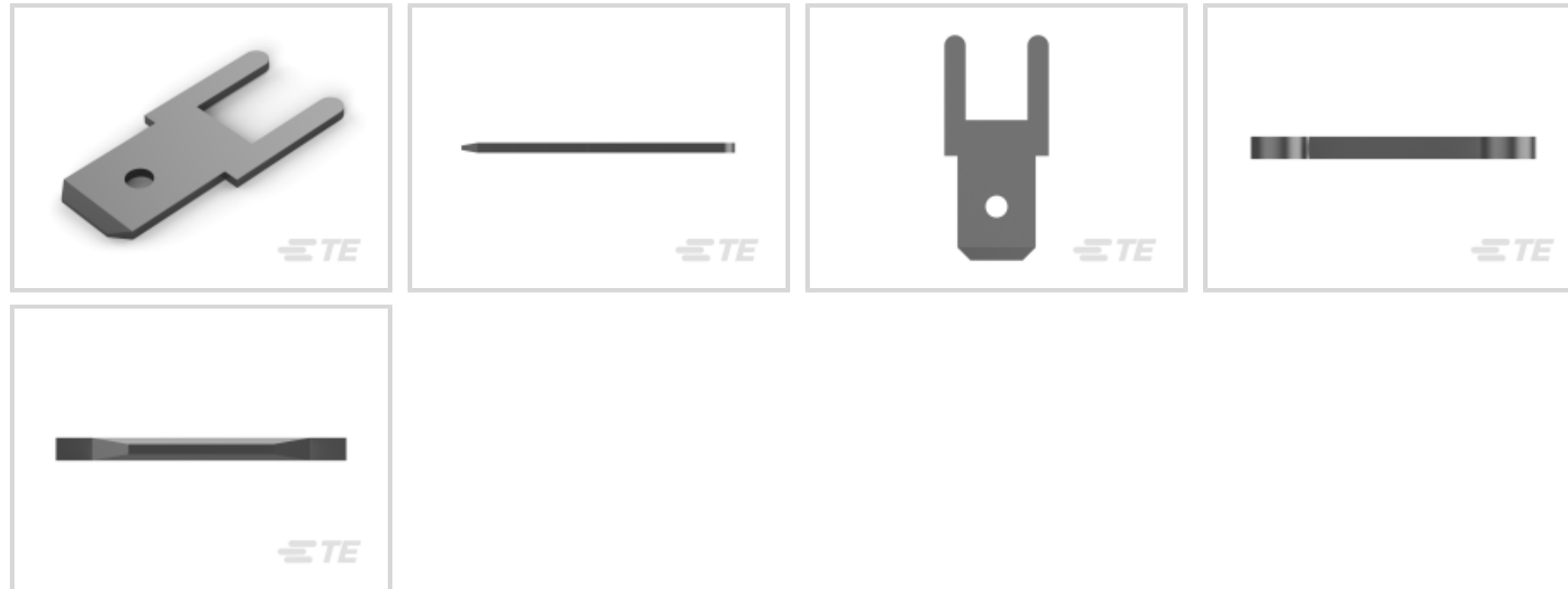




端子 and 接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 3.63 – 4.45 mm [.143 – .175 in]

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

PCB 孔直径: 1.4 mm [.055 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4.5 μm[177.16 μin]
端子底板材料厚度	2.5 μm[98.42 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	4.5 μm[177.16 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子电镀材料	锡
端子尺寸	4.75
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

板下延伸	5.2 mm[.204 in]
------	-----------------



PCB 厚度 (建议)	3.63 – 4.45 mm [.143 – .175 in]
PCB 孔直径	1.4 mm [.055 in]
PCB 的外形高度	8.6 mm [.343 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C [-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

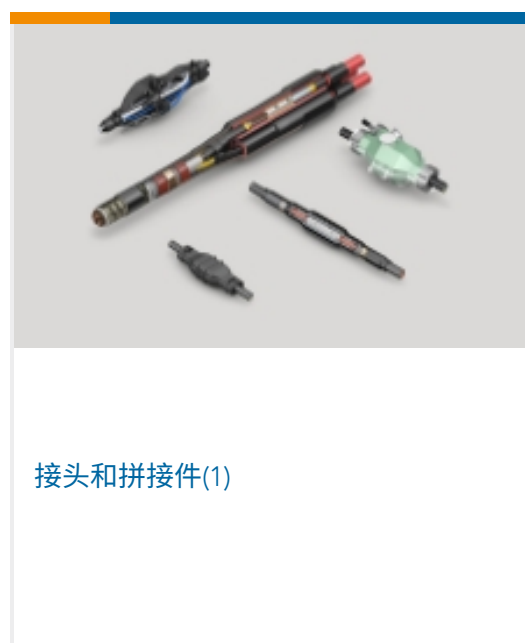
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

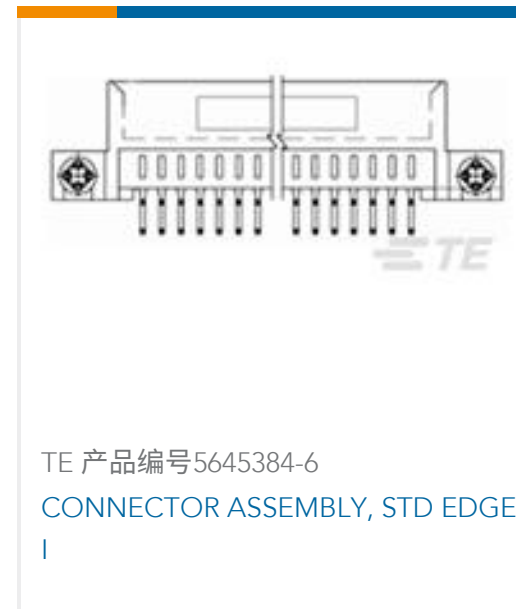
配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 187



客户还购买了



文档

产品图纸

[187 FASTON TAB TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_726388-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_726388-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_726388-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本